

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

521

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

10.08.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	213		2	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3	
		35	L2		
A-RS-FR4-ML-0.71mm-035+035-TG150-HF	50200660	710		4	A01
		35	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6	B00
		35	L4		
A-RS-FR4-ML-0.71mm-035+035-TG150-HF	50200660	710		7	A02
		35	L5		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	213		8	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	10	

Dicke nach Verpressen

B00:

2290 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2530 µm

Dmin:

2050 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2400 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2640 µm

Dmin:

2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

2217 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik